

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-256470

(43)公開日 平成10年(1998)9月25日

(51)Int.Cl.

H 01 L 25/055  
25/07  
25/18

類別記号

F I

H 01 L 25/08

B

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全6頁)

(21)出願番号

特願平9-55176

(71)出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(22)出願日 平成9年(1997)3月10日

(72)発明者

坪野谷 誠

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 安富 耕二 (外1名)

(54)【発明の名称】 半導体装置

(55)【要約】

【課題】複数の半導体チップを接着する接着性の接着剤に粒径が一定なフィラーを混入することによりチップ間の接觸事故を防止する。

【解決手段】マイランド12上に第1の半導体チップ10を固定し、第1の半導体チップの上に第2の半導体チップ11を接着する、各半導体チップ10、11のボンディングパッド12とリード端子17とをワイヤボンディングし、各半導体チップ10、11を含む主要部を樹脂17でモールドする、第2の半導体チップ11を接着する両2の接着剤15は粒径が20～40μの接着性カーボン10を混入する。